

有机硅导热灌封胶

一、产品特点及应用

HCY5299 是一种低粘度阻燃性双组分加成型有机硅导热灌封胶，可以室温固化，也可以加热固化，具有温度越高固化越快的特点。本品在固化反应中不产生任何副产物，可以应用于 PC(Poly-carbonate)、PP、ABS、PVC 等材料及金属类的表面。适用于电子配件导热、绝缘、防水及阻燃，其阻燃性可以达到 UL94-V0 级。完全符合欧盟 ROHS 指令要求。

二、固化前后技术参数

	性能指标	A 组分	B 组分
固化前	外观	深灰色流体	白色流体
	粘度 (cps)	3300	3500
操作	A 组分 : B 组分 (重量比)	1 : 1	
	混合后黏度 (cps)	3000 ~ 4000	
	可操作时间 (min)	120	
性能	固化时间 (min)	480	
	固化时间 (min, 80)	20	
固化后	硬度(shore A)	60	
	导热系数 [W (m·K)]	0.8	
后	介电强度 (kV/mm)	≥27	
	介电常数 (1.2MHz)	3.0 ~ 3.3	
	体积电阻率 (Ω·cm)	≥1.0×10 ¹⁶	
	线膨胀系数 [m/ (m·K)]	≤2.2×10 ⁻⁴	
	阻燃性能	94-V0	

以上性能数据均在 25℃，相对湿度 55% 固化 1 天后所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。

三、使用工艺

- 1、混合前，首先把 A 组分和 B 组分在各自的容器内充分搅拌均匀。
- 2、混合时，应遵守 A 组分 : B 组分 = 1 : 1 的重量比。
- 3、一般而言，20mm 以下的模压可以模压后自然脱泡，因为温度高造成固化速度加快或模压深度较深，所以可根据需要进行脱泡。这时为了除去模压后表面和内部产生的气泡，应把混合液放入真空容器中，在 0.08MPa 下至少脱泡 5 分钟。
- 4、应在固化前后技术参数表中给出的温度之上，保持相应的固化时间，如果应用厚度较厚，固化时间可能会超过。室温或加热固化均可。胶的固化速度受固化温度的影响，在冬季需很长时间才能固化，建议采用加热方式固化，80 ~ 100℃ 下固化 15 分钟，室温条件下一般需 8 小时左右固化。

四、包装规格

20Kg/套。(A 组分 10Kg +B 组分 10Kg)

五、贮存及运输

- 1、本产品的贮存期为 1 年 (25℃ 以下)。
- 2、此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。
- 3、超过保存期限的产品应确认有无异常后方可使用。